

Company Name : Frontken Corporation Berhad
Date : 12 September 2018
Source : Sin Chew Daily



主評：馬銀行研究

●公司背景

前研科技集團（FRONTKN,0128,主板科技組）于1996年創立，是首要的表面工程處理及為各項應用市場領優勢器材零件提供精密清潔服務，特別是半導體及油氣領域，主要服務地區包括台灣、新加坡及大馬市場。在半導體領域方面，占有大馬90%市占率，若以營收為準，台灣業務則是當地第二大的服務供應商。

2017財政年，56.8%營業額來自台灣、新加坡15.7%、大馬17.2%、菲律賓5.9%以及其他則為4.4%。台灣占2017財政年營運盈利的逾80%。

●業務推動力

過去兩年來，前研科技集團投資4000萬令吉在新高精密清潔科技及重新創新其現有的台灣設施，使營運可服務晶圓組裝半導體器材更加複雜的部件。

該公司也從原庄器材制造商結盟中受惠，特別是與Lam研究結盟，即可向後者的客戶提供清潔、維修及重新裝置服務。Lam研究為首要的晶圓組裝器材供應商，以為全球半導體工業提供服務。兩家公司的結盟將可分享科技及涉足研究與開發計劃。

內部研發能力強

前研科技集團本身擁有很多內部研發能力，以為特定需求客戶提供全面工程服務，以確保交付可靠及高素質服務。主要是研究集中在發展新研程序及原料，以為強勁擴張的應用市場提供服務。專業專注在確定方法為客戶生產程序提供創新方案。

前研科技集團業務成長主要落在邏輯及記憶半導體市場客戶，占公司總營收逾三分之二，它5年複合平均成長率達21%（2012至2017年）至2億3500萬令吉，這主要是行業成長強勁推動其服務需求。該行業全球半導體銷售營收的5年複合平均成長率達7.2%。

2013財政年出現轉捩點，即智慧電話變得日益流动及產品需求顯著增加。該公司的生產線提升以應付日益增長的高階電子產品晶片需求，如平面電腦及智慧型手機等，使它的器材使用率達到偏高水平。

2012年至2017財政年的全球智慧型手機銷售的5年複合平均成長率達到17.7%，去年占全球最大的晶片市場達32%水平。

該公司另一個潛在盈利成長來源為油氣相關領域，目前占公司總營業額的13.9%，不過它在2017財政年的

營運盈利卻是低於5%。熱能涂层服務主要應用在轉動部件防蝕用途，如閥門、水泉及壓縮器等，有助改善服務中的器材表現及延長使用期的能力，從而減少營運及保養器材成本。

油氣及相關領域前景正面，預料2018年至2019年原油價格每桶介於70美元至75美元之間。除了地緣政治的供應風險，全球原油庫存及岸外儲存倉皆下跌。惟頁岩油供應增加為潛在負面因素。

●業務表現

前研科技集團2018財政年次季核心淨利走高至1080萬令吉（按年漲55%及按季起60%），使其2018財政年首半年核心淨利達1750萬令吉（按年增26%），主要是穩健成本管理使營收及賺幅有增無減所致。

馬銀行研究將其2018至2020財政年淨利預測上调7%至10%之間，主要反映其新加坡業務的營收及營運盈利預測，分別增加至5950萬令吉及960萬令吉（之前預測為5080萬令吉及500萬令吉），因更多新工程及賺幅改善推動，以及較低有效稅率，即2018財政年之前預測33%下跌至28%水平，主要是缺少了預付稅務所致。

●資產負債表

前研科技集團擁有健全資產負債表，負債偏低及強勁的現金流。截至2018年3月杪為止，淨現金為9520萬令吉（每股現金為9仙），以及借貸僅為2680萬令吉。這使它過去兩年的新器材的開銷具有彈性。隨著營造健康的現金流，公司的淨現金情況將進一步擴張。

沒正式股息政策

前研科技集團沒有正式的股息政策，不過，去年派發每股0.5仙股息，為自2011年以來首次派息，特別是去年取得創紀錄淨利2990萬令吉。預料股息派發率為20%，使2018至2020財政年的每股股息預測分別為0.7仙、0.8仙及1仙。

我們將目標價上调10%至69仙，或等於其2019財政年預測本益比15倍（0.5高於其3年平均標準差），維持其“買進”評級。

●潛在風險

智能手機及電子器材需求走低，導致其設施的使用率下跌、新進科技的投資及其他市場缺乏發展、以及原油價格急挫及石油業的資本開銷走低，主要是油氣業服務需求走低。